VECTECH 威鐵克

BGA3000DX

BGA 紅外線返修系統

BGA / SMD REWORK SYSTEM

專業 精準控溫

穩定 高效返修

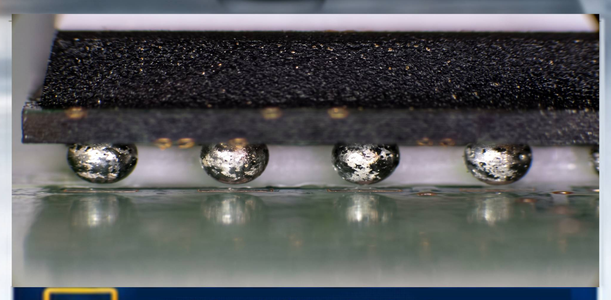
廣泛 應用領域

紅外線上下加熱系統

採用紅外線加熱技術，
上下獨立溫控，溫度均勻，
適用各類BGA/SMD零件返修。

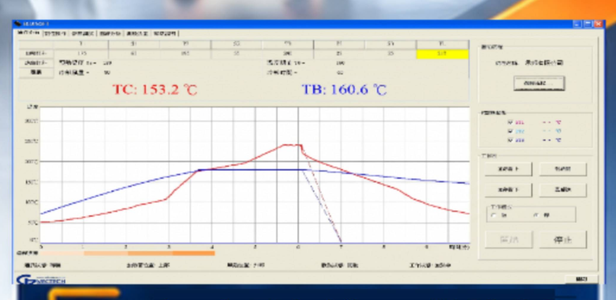
精密光學對位

鏡頭影像放大，搭配光學對位，
提供平台X/Y手動微調，協助
晶片與PCB焊點精準對位。



回流監控系統 (RPC)

即時監控焊點回流狀態，
搭配影像觀察與分析，
提升返修品質與良率。



溫度監測與工藝控制

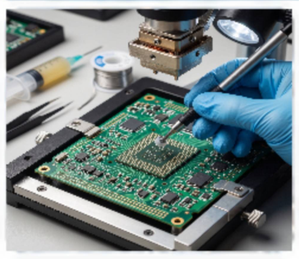
非接觸式溫度監測，
可設定多段加熱流程，
精準控制返修工藝。

規格表

產品型號	BGA3000DX
紅外線加熱總功率	3,400 W (max)
底部預熱功率	2,400 W (400 W x 6)
底部預熱面積	232 x 232 mm
頂部缸外線加熱功率	720W (120 W x 6)
頂部加熱視窗	2x 2 ~ 60 x 60 mm
最大 PCB 尺寸	400 x 400 mm
設備淨重	約90kg

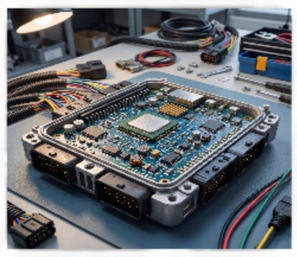
※以上規格資料依原廠產品說明書整理，若有變更，請以實際規格為準。

應用領域



BGA 晶片返修

主機板維修



汽車電子

AI伺服板

VECTECH 威鐵克

承邦有限公司 Chen Bom Trading Co., Ltd.

02-8647-2988

新北市汐止區大同路三段190號8樓

www.cbtrade.com.tw

掃描了解更多產品資訊